



PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

<p>(51) 国際特許分類7 H05K 1/11</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/36886</p> <p>(43) 国際公開日 2000年6月22日 (22.06.00)</p>																														
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP99/06428</p> <p>(22) 国際出願日 1999年11月17日 (17.11.99)</p> <p>(30) 優先権データ</p> <table border="0"> <tr> <td>特願平10/357039</td> <td>1998年12月16日 (16.12.98)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/34616</td> <td>1999年1月4日 (04.01.99)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/97648</td> <td>1999年4月5日 (05.04.99)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/97649</td> <td>1999年4月5日 (05.04.99)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/97650</td> <td>1999年4月5日 (05.04.99)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/104294</td> <td>1999年4月12日 (12.04.99)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/231931</td> <td>1999年8月18日 (18.08.99)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/231932</td> <td>1999年8月18日 (18.08.99)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/231933</td> <td>1999年8月18日 (18.08.99)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/231934</td> <td>1999年8月18日 (18.08.99)</td> <td>JP</td> </tr> </table> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) イビデン株式会社 (IBIDEN CO., LTD.) [JP/JP] 〒503-0917 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地 Gifu, (JP)</p>		特願平10/357039	1998年12月16日 (16.12.98)	JP	特願平11/34616	1999年1月4日 (04.01.99)	JP	特願平11/97648	1999年4月5日 (05.04.99)	JP	特願平11/97649	1999年4月5日 (05.04.99)	JP	特願平11/97650	1999年4月5日 (05.04.99)	JP	特願平11/104294	1999年4月12日 (12.04.99)	JP	特願平11/231931	1999年8月18日 (18.08.99)	JP	特願平11/231932	1999年8月18日 (18.08.99)	JP	特願平11/231933	1999年8月18日 (18.08.99)	JP	特願平11/231934	1999年8月18日 (18.08.99)	JP	<p>(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ) 広瀬直宏 (HIROSE, Naohiro) [JP/JP] 伊藤 均 (ITO, Hitoshi) [JP/JP] 岩田義幸 (IWATA, Yoshiyuki) [JP/JP] 川出雅徳 (KAWADE, Masanori) [JP/JP] 〒501-0695 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1丁目1番地 イビデン株式会社 大垣北工場内 Gifu, (JP) 矢津 一 (YAZU, Hajime) [JP/JP] 〒503-0973 岐阜県大垣市木戸町905番地 イビデン株式会社 大垣工場内 Gifu, (JP)</p> <p>(74) 代理人 弁理士 田下明人, 外 (TASHITA, Akihito et al.) 〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津2丁目1番27号 堀井ビル3階 Aichi, (JP)</p> <p>(81) 指定国 KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
特願平10/357039	1998年12月16日 (16.12.98)	JP																														
特願平11/34616	1999年1月4日 (04.01.99)	JP																														
特願平11/97648	1999年4月5日 (05.04.99)	JP																														
特願平11/97649	1999年4月5日 (05.04.99)	JP																														
特願平11/97650	1999年4月5日 (05.04.99)	JP																														
特願平11/104294	1999年4月12日 (12.04.99)	JP																														
特願平11/231931	1999年8月18日 (18.08.99)	JP																														
特願平11/231932	1999年8月18日 (18.08.99)	JP																														
特願平11/231933	1999年8月18日 (18.08.99)	JP																														
特願平11/231934	1999年8月18日 (18.08.99)	JP																														
<p>(54) Title: CONDUCTIVE CONNECTING PIN AND PACKAGE BOARD</p> <p>(54) 発明の名称 導電性接続ピン及びパッケージ基板</p> <div data-bbox="503 1260 1088 1722"> </div> <p>(57) Abstract</p> <p>On the board provided with a conductive layer (5), a pad (16) is formed to fix a conductive connecting pin (100) on a package board (310). The conduction connecting pin (100) serves as electrical connection to a motherboard. The pad (16) is coated with an organic-resin insulating layer (15) having an opening section (18) from which the pad (16) is partially exposed. The conductive connecting pin (100) is fixed to the pad exposed from the opening section using a conductive adhesive (17), preventing the conductive connecting pin (100) from separating off the board at the time of mounting.</p>																																